

2017～18年の最新機器の分解から見る 新たな技術、マーケットトレンド

講師：清水洋治 氏

株式会社テカナリエ 代表取締役 CEO

実際の世界的ヒット商品の分解情報を元に新たな技術トレンド、方向性などを解説します。またAI、ADASなどに活用される半導体やシステムの実例をもとに2020年以降の方向性を解説します。

【講師経歴】日立半導体～2003年、米国駐在 1998～2004年 半導体ベンチャー ルネサス 2005～2015年 設計開発、マーケット、主管技師長、テカナリエ CEO 2016年～

【活動】テカナリエとして日経BP社技術者塾講師 年4回 未来展望を執筆、EETimesにて アジア分解/次の10年などを連載、年間300製品分解、1,000チップ解析などを行い、トレンド、技術を俯瞰してのセミナーを年に50回ほど実施しています

開催日時	2018年4月13日(金) 13:30～16:30	【会場】 ちよだプラットフォームスクウェア ミーティングルーム 5F 503 会議室 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-21
受講料	48,000円(税込) ※資料代金 *メルマガ登録者 43,000円(税込) *アカデミック価格 15,000円(税込)	

*アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。

★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合2人目以降はメルマガ価格の半額です。

★【セミナー対象者】最新機器、スマートフォン、スマートスピーカー、AI機器などの内部構造を理解し、今後の成長トレンドなどを理解したい技術者、経営者、マーケット関係者。中国などの取り組みを理解したい経営者。

★【セミナーで得られる知識】最新機器の構成の基本形や日本の弱い部分などの理解。また2020年以降の新たなトレンドなどの方向性に関する知識全般。

【本セミナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

1 Apple/Googleらの最新製品分解による動向

- 1.1 iPhone8/X
- 1.2 Apple Watch
- 1.3 Google Pixel 2

2 中国最新製品群の分解による動向

- 2.1 HUAWEI Mate 10
- 2.2 ZTE スマートフォン
- 2.3 IoT ガジェット
- 2.4 中国製車載製品

3 AI、ADAS、AR/VRなどの最新動向

- 3.1 AIスピーカー4機種
- 3.2 AR機器 Microsoft
- 3.3 ADAS 内蔵ドライブレコーダー
- 3.4 NVIDIA GPU
- 3.5 IoTの全体構造
- 3.6 RISC-Vなど新ムーブメントの状況

※上記内容を各50頁の資料にて解説を行います。

弊社記入欄		セミナー申込書	
セミナー名		2017～18年の最新機器から分解から見る新たな技術、マーケットトレンド	
所定の事項にご記入下さい メルマガ会員、 登録希望の場合は○↓		会社名(団体名)	TEL:
		住所 〒	FAX:
			E-mail:
会員登録済み	新規登録希望	部署	役職
		氏名	
お支払方法		銀行振込・その他	お支払予定 2018年 月 日頃

■申込方法: セミナー申込書にご記入の上 FAX または E-mail (re@cmcre.com) でお申し込みください。

■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしていません、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

■申込先: ㈱シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町2-7 TEL 03-3293-7053

■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧になれます。⇒ <http://www.cmcre.com>

参加申込 FAX 番号
03-3291-5789